**2023中国真空技术与半导体应用大会**

**---暨半导体真空设备与零部件高端论坛**

**附件2-会议参会回执表**

**填表时间：2023年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | 邮 编 |  |
| 经办姓名 |  | | 职 务 |  | 电 话 |  |
| 手 机 |  | | 部 门 |  | E-mail |  |
| 代表姓名 | 性别 | 部门 | 职务/职称 | 手机 | E-mail | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 论文摘要  题目 |  | | | | * 口头报告 □ 墙报展示 | |
| 收款单位 | 收款单位：上海复创芯半导体科技有限公司  开 户 行：交通银行股份有限公司上海同济支行  帐 号：310066 344013 005923 958  开户银行行号：1023 6100 2264 | | | | | |

**会议Email**：[kjyzy@fudan.edu.cn](mailto:kjyzy@fudan.edu.cn)

**院校师生报名及论文投递联系人**，刘老师，电话：13918283051

**企业报名、赞助及酒店住宿联系人**，王老师，电话：13817092767